

证券代码：300223

证券简称：君正股份

公告编号：2026-059

北京君正集成电路股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格上限及 H 股
香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025 年 9 月 15 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于 2026 年 5 月 26 日重新向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 15 日和 2026 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-058）、《关于重新向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-040）。

2026 年 6 月 24 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1481 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市股份（H 股）获中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-043）。

2026年7月30日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2026年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2026-050）。

2026年8月9日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于2026年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-055）。

2026年8月17日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。A股投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站刊登的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0817/2026081700004_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0817/2026081700003.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股基础发行股数为31,287,300股（视乎超额配售权行

使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 3,128,800 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 28,158,500 股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的 90%。

自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过 4,693,000 股 H 股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 35,980,300 股。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过 102.80 港元。公司 H 股香港公开发售于 2026 年 8 月 17 日开始，预计于 2026 年 8 月 20 日结束，并预计于 2026 年 8 月 24 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.ingenic.com.cn）。

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 8 月 25 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十七日